**CON CORTESE RICHIESTA DI IMMEDIATA PUBBLICAZIONE**

**[LOGO SAMTEC] Luglio 2021**

**Samtec introduce la famiglia di array ad alte prestazioniAcceleRate® HP**

*La base per nuove soluzioni di interconnessione PICMG COM-HPC®*

**New Albany, Indiana –**  Samtec Inc., una multinazionale a proprietà privata da 800 milioni di dollari che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettroniche, annuncia il lancio degli array ad alte prestazioni AcceleRate HP di nuova generazione, che supportano le estreme velocità di trasmissione PAM4 – 112 GB/s – in un ingombro ultra-micro.

Gli array ad alte prestazioni AcceleRate HP presentano una configurazione a pin aperta che massimizza la flessibilità della messa a terra e dell’instradamento. Gli architetti di sistemi possono utilizzare linee di tensione ad alta corrente e segnali sbilanciati, a coppie differenziali, attraverso lo stesso sistema di interconnessione.

Inoltre, il passo delle file – 2,2 / 2,4 / 2,2 mm – facilita l’instradamento di segnali differenziali. La diafonia è migliore grazie al maggiore spazio e alla possibilità di aggiungere ulteriori fori di vias intorno ai segnali differenziali.

“I nuovi array ad alte prestazioni AcceleRate HP di Samtec stabiliscono lo standard per le altissime velocità di trasmissione PAM4 – 112 GB/s – con un ridotto fattore di forma”, spiega Michael Boone, Product Manager High-Speed Board-to-Board presso Samtec, Inc. “Varie applicazioni in rapida diffusione – acceleratori IA, emulatori ASIC e piattaforme di edge computing di nuova generazione – possono utilizzare questi vantaggi unici”.

Caratteristiche chiave degli array ad alte prestazioni AcceleRate HP:

* Passo di notevole densità: 0,635 mm
* Altezze di impilamento a basso profilo – 5 mm – e fino a 10 mm
* Fino a 400 pin in totale disponibili
* Piani in corso per arrivare a oltre 1.000 pin
* Velocità di trasmissione dati compatibile con PCIe® 5.0 e 100 GbE
* Terminazione BGA per facilitare l’assemblaggio e l’autoallineamento

Per maggiori informazioni sugli array ad alte prestazioni AcceleRate HP visitare [www.samtec.com/accelerateHP](http://www.samtec.com/accelerateHP).

**Connettori PICMG COM-HPC**

Le nuove specifiche PICMG COM-HPC offrono flessibilità del sistema e dell’interfaccia adottando una coppia di connettori a 400 pin basata sugli array ad alte prestazioni AcceleRate HP di Samtec. I connettori Samtec COM-HPC collegano le portanti a moduli server e client, e supportano interfacce attuali e future, quali PCIe5.0 e fino a 100 GbE. Le coppie di connettori supportano un’altezza di impilamento di 5 mm o 10 mm.

Per ulteriori informazioni sui connettori Samtec COM-HPC, scaricare la [brochure sulle soluzioni di interconnessione COM-HPC](https://suddendocs.samtec.com/ebrochures/samtec-com-hpc-ebrochure.pdf), visitare [www.samtec.com/COMHPC](http://www.samtec.com/COMHPC) o inviare un’email ai nostri esperti tecnici all’indirizzo [COMHPC@samtec.com](mailto:COMHPC@samtec.com).

**Informazioni su Samtec**Fondata nel 1976, Samtec è una multinazionale a proprietà privata da 800 milioni di dollari che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettroniche – da scheda a scheda ad alta velocità, cavi per frequenze elevate, dispositivi ottici da pannello e mid-board, componenti e cavi RF di precisione, per impilamento flessibile ultracompatti/estremamente robusti. Con oltre 40 sedi nel mondo e prodotti venduti in più di 125 Paesi, Samtec vanta una presenza globale che le permette di offrire un servizio clienti ineguagliato. Per saperne di più visitare [http://www.samtec.com](http://www.samtec.com/).

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Telefono: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[**www.samtec.com**](http://www.samtec.com)

###

**Referente PR**

Matt Burns

[matthew.burns@samtec.com](mailto:matthew.burns@samtec.com)

812-944-6733